WLP-4-01/02/04 : 許容損失 / Power Dissipation

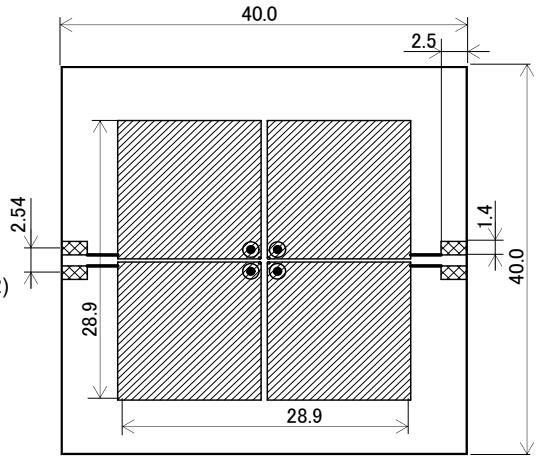
許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

Allowable loss varies depending on mounting conditions, etc.,
so the data below is for reference only based on the following mounting conditions.

1. 測定条件 (参考データ) / Test Result (Referential Data)

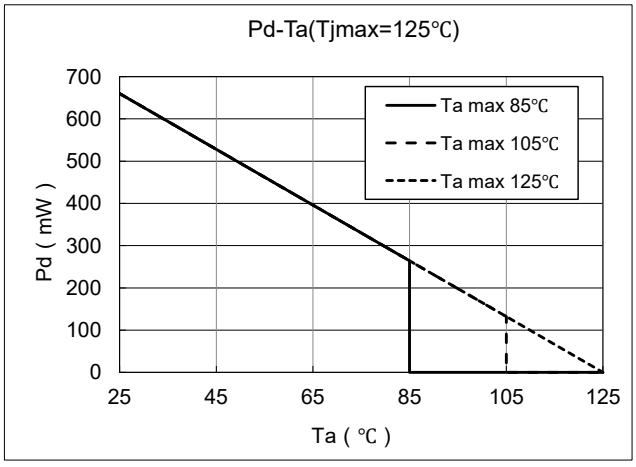
測定条件: 基板実装状態
雰囲気: 自然対流
実装: Pbフリーはんだ
実装基板: 4層基板40mm×40mm(片面1600mm2)に対して銅箔面積
1層目: 約50%_各リード接続
2層目: 約50%_各リード接続
3層目: 約50%_各リード接続
4層目: 約50%_各リード接続
基板材質: ガラスエポキシ(FR-4)
板厚: 1.6mm
スルーホール: ホール径 0.8mm 4個
銅箔厚: 18um

Test Conditions : being mounted on a FR-4 PCB
Atmosphere : Naturally Convection
Solder : Pb Free Solder
PCB Size : 40mm×40mm four-layer substrate (One side-1600mm2)
Copper foil area : Layer 1 Approximately 50%_Each lead connection
Layer 2 Approximately 50%_Each lead connection
Layer 3 Approximately 50%_Each lead connection
Layer 4 Approximately 50%_Each lead connection
PCB Material : Glass Epoxy (FR-4)
PCB Thickness : 1.6mm
Through Hole : Via.0.8mm 4pcs
Copper foil thickness : 18um



評価基板レイアウト / PCB design (Unit:mm)

2. 許容損失 - 周囲温度特性 / Power Dissipation-Ambient Temperature Characteristic

Tjmax = 125℃

Ta (℃)	Pd (mW)			θ_{ja} (℃/W)
	Ta max 85℃	Ta max 105℃	Ta max 125℃	
25	660	660	660	151.5
85	264	264	264	
105	0	132	132	
125	0	0	0